



**2021년 2월 25일(목) 석간부터** 보도하여 주시기 바랍니다.  
(인터넷, 방송, 통신은 2. 25.(목) 오전 10시 이후 보도 가능)

배포일시	2021. 2. 24.(수)	담당부서	산업부 반도체디스플레이과 중기부 미래산업전략팀 금융위 산업금융과
담당과장	조익노 과장(044-203-4270) 이두연 팀장(042-481-3913) 선욱 과장(02-2100-2860)	담당자	박성수 사무관(044-203-4274) 허창기 사무관(042-481-3918) 이영민 사무관(02-2100-2865)

## 민간투자·금융지원으로 시스템반도체 성장을 견인한다.

- 시스템반도체 133조원 투자, 반도체 클러스터 등 대규모 프로젝트 지원 -
- 총 6,500억원 규모의 펀드 조성으로 반도체 생태계 육성 -
- 시스템반도체 등 BIG3 분야 우대금리·특례보증 제공 -

- 정부는 2월 25일 제5차 혁신성장 BIG3 추진회의(주제 : 경제부총리)를 개최하고, 시스템반도체 산업의 지속적인 성장 생태계 조성을 위한 「시스템반도체 분야 민간투자 실행 가속화 및 투자·보증 강화 방안」을 발표하였다.
    - 同 방안을 통해 정부는 국내 반도체 제조 인프라 확대를 위해 대규모 민간투자의 차질없는 이행을 지원하고 다양한 펀드 및 정책금융 프로그램을 활용하여 시스템반도체 경쟁력을 제고해 나갈 계획이다.
  - 먼저, 국내 주요기업의 대규모 민간투자 프로젝트와 관련된 행정절차 이행, 규제 완화 등을 조속히 추진하여, 변화하는 반도체 시장에 적기 대응할 수 있도록 지원한다.
    - 이를 위해, 현재 추진 중인 ①시스템반도체 133조원 투자, ②용인 반도체 클러스터 조성 등 대규모 민간투자 추진 과정에서 발생하는 애로사항은 관계부처간 협의\*를 통해 조기에 해소하고,
- \* 기업의 투자 애로 접수(산업부) → 관계부처간 애로 해소 협의 → 정부 협의체 상정·의결

- 최근 소부장 특화단지로 지정된 용인 반도체 클러스터는 올해 연말까지 착공할 수 있도록 관련 절차\*를 조속히 이행할 예정이며, 향후 기반시설(용수, 전력 등)의 적기 구축을 지원한다.

\* 수도권정비위원회 심의의결(~3월 1주) → 산단계획 승인('21.3월중) → 산단 공사 착공('21.4분기) → 1단계 Fab 착공('23년) → 산단 조성 및 1단계 Fab 완공('25년초)

### 용인 반도체 클러스터 개요

- (사업비) 총 120조원 (장비구매 등 포함), 산단 조성비 1.8조
- (사업기간) '19~'25년 ('21.4Q 산단 공사 착공)
- (내용) ①반도체 4개 Fab 신설, 최대 80만/월 생산능력 확보  
②50개 이상 협력업체가 입주하는 상생형 클러스터 조성  
③스마트산단 적용 및 창업활성화 등 혁신활동 지원
- (기대효과) 1.7만명 신규 직접고용



- 아울러, 시스템반도체 기업의 경쟁력 제고를 위해 민간을 중심으로 조성된 총 6,500억원의 펀드를 활용하고, 이 중 2,800억원은 기존 펀드의 후속펀드 및 신규펀드로 마련한다.

\* (팹리스) 반도체 제조시설 없이 SoC 설계·개발을 수행하는 설계 전문기업 (디자인하우스) 설계된 회로를 파운드리에서 생산 가능하도록 최적화 서비스를 제공하는 기업

- ① 시스템반도체 상생펀드(총 1,000억원)는 연내 400~500억원을 투자하고, 올해 500억원 규모의 하위펀드를 조성할 계획이다.
- ② 반도체성장펀드(총 2,000억원)는 하위펀드로 약 300억원 규모의 M&A 프로젝트 펀드를 신규 조성한다.
- ③ 또한, 지난해 1,500억원 규모로 마련된 D.N.A+BIG3 펀드는 올해 1,000억원 규모의 후속펀드를 조성하여 총 2,500억원의 투자재원을 확보할 예정이며,
- ④ 반도체 산업의 소재·부품·장비 분야 중견·중소기업을 중점 육성하기 위해 ④총 1,000억원 규모의 소부장 반도체 펀드도 연내 신설한다.

< 시스템반도체 분야에 투자 가능한 대표 민간펀드 >

분야	규모	'21년 주요계획
시스템반도체 상생펀드	1,000억원	▶ 400~500억원 투자 추진, 500억원 규모의 하위펀드 조성
반도체성장펀드	2,000억원	▶ 약 300억원 규모의 M&A 프로젝트 펀드 조성
D.NA+BIG3 펀드	2,500억원	▶ 1,000억원 규모의 후속펀드 추가 조성
소부장 반도체 펀드	1,000억원	▶ 연내 신규 조성 예정

□ 마지막으로, 정책자금 대출 및 정책보증 프로그램을 활용하여 시스템 반도체 기업의 신규 투자를 활성화하고, 민간기업의 자생적인 성장 기반 조성을 지원한다.

○ 산업 경쟁력 강화를 위해 마련된 산업은행, 기업은행 등의 정책자금을 활용하여 중견·중소기업의 신규투자를 촉진한다.

\* ('21년 지원규모) ▲산업구조 고도화 프로그램 : 3조원, ▲대한민국 대전환 뉴딜 특별자금 : 3.5조원

< 시스템반도체 분야에 지원 가능한 대표 프로그램 >

구분	주요내용	
산업구조 고도화 프로그램 (산은, 기은)	지원 분야	▶ (중견·중소기업 투자) 주력산업* 경쟁력 제고 및 신산업 창출·확산 등에 필요한 설비·기술투자 * 소재·부품·장비, 반도체·디스플레이·배터리, 자동차·조선, 섬유·가전, 석유화학 등 ▶ (대중소 상생투자) 협력업체 설비투자·기술개발 및 밸류체인 단위투자 ▶ (사업재편) 사업구조 개선 및 신시장 진출·사업장 이전
	지원 조건	▶ (지원한도) [산은] (시설자금) 최대 2,500억원, (운영자금) 최대 300억원 [기은] (시설자금) 최대 250억원, (운영자금) 최대 30억원 ▶ (여신기간) [산은] (시설자금) 10년 이내, (운영자금) 3년 이내 [기은] (시설자금) 15년 이내, (운영자금) 5년 이내 ▶ (금리우대) 0.5~0.7%p 감면
대한민국 대전환 뉴딜 특별자금 (산은)	지원 분야	▶ 뉴딜투자 공동기준 분야* 및 품목 영위 기업, 정부 추진 뉴딜사업 참여 기업 * 뉴딜투자 공동기준 : 시스템반도체, AI 칩 등 차세대 반도체 포함 총 40개 분야
	지원 조건	▶ (여신기간) [시설자금] 최대 20년, [운영자금] 3년 이내 ▶ (금리우대) 최대 중소·중견 0.8%p 대기업 0.2%p 감면

○ 기술보증기금의 4차 산업혁명 프로그램 운영 시 D.N.A+BIG3 분야 기업은 핵심기업으로 분류하여 우대 조건\*을 제공하고, 보증한도 심사 시 新기술평가시스템\*\*을 활용하여 맞춤형으로 지원한다.

\* ①보증료 0.3%p 감면, ②보증 비율 95% 적용, ③운전자금 사정 생략(~2억원)

\*\* 분야별 영위업종 변수 분석에 AI 접목 / 기술 차별성, 모방 난이도 등 미래 성장 지표에 가중치 부여

- 이와 함께, 신용보증기금에서도 ①뉴딜기업 특화보증\*, ②소부장 협력 모델 특례보증\*\* 등 보증한도 특례 프로그램을 활용하여 시스템반도체 기업을 적극적으로 지원할 계획이다.

\* (뉴딜기업 특화보증) 보증료율 최대 △0.4%p 및 보증비율 최대 95% 지원

\*\* (소부장 협력모델 특례보증) 보증료율 최대 △0.3%p 및 보증비율 최대 90% 지원

□ 박진규 산업부 차관은 “시스템반도체가 진정한 성장궤도에 안착하기 위해서는 **활발한 민간투자**가 바탕이 되는 **자생적 생태계 조성**이 반드시 필요하며, 이번에 **대규모 금융**이 반도체 생태계 전반에 공급되면 시스템반도체 기업의 **창업과 스케일업**을 촉진할 것으로 기대된다.”면서,

- “업계 및 관계부처와 협력을 통해 민간투자 애로사항을 신속하게 해소하고, 우리 기업이 정책금융과 민간펀드를 적극적으로 활용하여 다양한 신규 투자가 추진될 수 있도록 지원해 나가겠다.”고 언급하였다.

**【붙임】 「시스템반도체 분야 민간투자 실행 가속화 및 투자·보증 강화 방안」**



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 반도체디스플레이과 박성수 사무관(☎ 044-203-4274)에게 연락주시기 바랍니다.